

中科软科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2023年度向银行申请综合授信额度100,000万元人民币。

具体情况如下：

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请免担保综合授信，用于补充公司流动资金：

一、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

二、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

三、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

四、向招商银行北京清华园科技金融支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

五、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

六、向华夏银行长安支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年。

上述授信银行、授信额度及期限、具体授信品种及用途将以银行最终实际审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日